

DIELEC PI

LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE SECADO RAPIDO

Código I-29-16, Versión 1, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

DIELEC PI es un desengrasante y limpiador de secado rápido para equipos electrónicos. Es una mezcla de solventes y gases no inflamables que permite una rápida limpieza de contactos electrónicos previniendo fallas y mal funcionamiento causado por el polvo, grasa, humedad, mugre, etc.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Rigidez Dieléctrica de 35.000 voltios.
- No inflamable, no conduce la humedad y no daña la capa de ozono.
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos.
- No es grasoso ni deja huellas.
- Amigable con el medio ambiente, ya que el aerosol no daña la capa de ozono.
- No contiene solventes fluorinados o clorados.

APLICACIONES.

Use **DIELEC PI** para radio, televisión, compañías eléctricas y electrónicas, concesionarios automotrices, empresas de transporte, municipalidades, servicios públicos, equipos electrónicos, tableros de control, y otros equipos similares.

Advertencia: no use en plásticos tales como acrílicos, polietileno, policarbonato, tereftalato, ABS, acetato de celulosa y cloruro de polivinilo.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Sostenga el aerosol a 15 o 20 cms de la superficie a limpiar, luego rocíe el producto sobre ella. Después de limpiar, deje secar completamente antes de colocar nuevamente en servicio.

Consulte la etiqueta del aerosol para indicaciones adicionales y precauciones antes de usar.

Somos la **Química** en su **Industria**



DIELEC PI

LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE SECADO RAPIDO

Código I-29-16, Versión 1, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido.

Color: Incoloro.

Olor: Solvente clorado.

Gravedad específica: 1.30 – 1.40

pH: N/A.

Solubilidad en agua: Insoluble.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Diclorometano.

CAS N°: 75-09-2

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad química: El material es estable bajo condiciones normales de temperatura y presión.

Posibilidad de reacciones peligrosas: No polimeriza.

Condiciones que deben evitarse: Calor fuerte, llamas, luz solar directa, chispas, descargas estáticas.

Materiales incompatibles: Evite el contacto con los materiales oxidantes. Evitar el contacto con: Bases fuertes.. Evitar el contacto con metales como: Polvos de zinc, polvos de aluminio, polvo de magnesio, potasio y sodio. Evitar contacto imprevisto con aminas.

Productos de descomposición peligrosos: Cloruro de hidrógeno. los productos de descomposición pueden incluir trazas de: Cloro, fosgeno.

PRESENTACIONES.

Aerosol de 20 onzas.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

